

기술분석보고서 화학

KX하이텍 (052900)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 한국기술신용평가(주) 작성자 임창용 전문연구원

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브(IRTV)로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 "한국IR협의회" 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-525-7759)로 연락하여 주시기 바랍니다.

KX하이텍(052900)

반도체 공정소재 및 SSD 관련제품 전문 제조기업

기업정보(2024.10.02. 기준)

대표자	강천석
설립일자	1997년 03월 05일
상장일자	2005년 01월 18일
기업규모	중소기업
업종분류	반도체 제조용 기계 제조업
주요제품	IC-Tray, Module-Tray, SSD Case 등

시세정보(2024.10.02. 기준)

현재가(원)	989
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	545
발행주식수(주)	55,107,517
52주 최고가(원)	1,700
52주 최저가(원)	888
외국인지분율(%)	1.26
주요주주(%) (주)케이엑스 이노베이션	31.52
최상주	1.77

■ 반도체 공정소재 및 SSD 관련소재 전문 제조기업

KX하이텍(이하 '동사')은 플라스틱 사출과 금속가공을 통해, 반도체 공정소재와 SSD(Solid State Drive) 관련소재를 제조하는 기업이다. 주요 제품으로는 반도체 공정에 보관 및 운송의 용도로 사용되는 IC 트레이(IC Tray)¹⁾, 모듈 트레이(Module Tray)²⁾ 등이 있으며, SSD 관련 제품으로는 보호 및 패키징의 용도로 사용되는 SSD 인클로저(SSD Enclosure)³⁾ 등을 생산하고 있다. 특히 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주) 등 주요 반도체 기업들을 고객사로 확보하여, 고부가가치 시장에서의 입지를 다지고 있다.

■ eSSD 시장 성장과 제조 유연성 요구 증대

플라스틱 사출시장은 전반적으로 성숙기에 접어들었으나, eSSD⁴⁾ 등 정밀 산업 분야에서 새로운 성장 기회가 열리고 있다. 다만, 코로나19 이후 eSSD를 포함한 정밀산업 분야에서는 공급망 리드타임⁵⁾ 증가 문제가 발생하고 있다. 따라서 정밀산업 고객사를 유치하고자 하는 플라스틱 사출업체는 이러한 공급망 이슈에 대한 효과적인 대응 전략을 마련해야 할 것으로 사료된다.

■ 원가절감 기술과 제조 유연성 확보

동사는 플라스틱 사출시장의 성숙기에 대응하기 위해, 『원가절감』⁶⁾과 『제조 유연성(Manufacturing Flexibility)』⁷⁾에 대한 기술력을 갖췄다. 우선, 동사는 원가절감을 위해 자동 원자재 관리 및 분배 시스템, 정밀 사출 공정 자동화, 자동화된 품질 관리 시스템을 구축한 것으로 확인된다. 또한 제조 유연성 측면에서는 유연 생산 시스템을 갖추고 있으며, 이를 통해 고객사의 다양한 요구사항에 맞춤형으로 대응할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 파악된다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2021	1,049	40.4	87	8.2	49	4.7	5.4	3.4	73.1	102	2,179	17.8	0.8
2022	1,564	49.1	123	7.8	145	9.3	13.6	7.9	64.5	283	2,178	4.2	0.5
2023	1,547	-1.1	81	5.3	47	3.1	3.9	2.5	66.6	81	2,123	15.0	0.6

1) IC 트레이(IC Tray): 칩회로(IC) 칩의 안전한 보관 및 운송을 위한 용기

2) 모듈 트레이(Module Tray): 메모리 모듈 등의 반도체 부품을 보관 및 운송하는 용기

3) SSD 인클로저(SSD Enclosure): SSD를 외부 충격과 환경으로부터 보호하는 케이스

4) eSSD(enterprise Solid State Drive): 기업용 서버와 데이터센터에 최적화된 고성능 저장장치로, 일반 SSD보다 높은 내구성과 안정성, 뛰어난 입출력 성능을 제공함

5) 리드타임(Lead Time): 주문부터 제품 납품까지 소요되는 총시간으로, 생산 계획, 원자재 조달, 제조, 운송 등의 과정을 포함함



6) 원가 절감에 대한 기술적 전략을 설명하는 용어는 다양하나, 본 보고서에서는 '원가절감 기술'로 통일하여 사용함

7) 제조 유연성: 다양한 제품 수요와 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 제조 능력

기업경쟁력

<p>원가절감 기술</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 동사는 자동 원자재 관리 및 분배 시스템, 정밀 사출 공정 자동화, 자동화된 품질 관리 시스템을 구축하여 원가를 절감함 • 또한 베트남으로의 생산기지 이전을 통해 인건비를 절감함
<p>제조 유연성</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 유연 생산 시스템을 갖추고 있으며, 다양한 제품군에 대한 생산 경험을 보유함 • 이를 통해 고객사의 다양한 요구사항에 맞춤형으로 대응할 수 있는 능력을 갖추

핵심 기술 및 적용제품

<p>반도체 공정소재</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IC 트레이와 모듈 트레이: 각각 집적회로와 메모리 모듈을 안전하게 보관 및 운반하는 데 사용됨 • 캐리어 테이프: 자동화된 조립 라인에 작은 전자 부품을 공급하는 역할을 함 • 웨이퍼 링 캐리어: 웨이퍼를 지지하고 보호하여 가공 과정의 안정성을 제공함 	<p>반도체 공정소재</p> 
<p>SSD 관련제품</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 동사의 주력제품은 SSD 인클로저와 턴키박스(Turnkey Box)⁸⁾ • 특히 SSD 인클로저는 SSD의 보호와 성능 유지에 중요한 역할을 함 • 동사는 고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 제품을 제공 중 	<p>SSD 관련제품</p> 

시장경쟁력

<p>주요 고객사 확보</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주) 등 주요 반도체 기업들을 고객사로 확보함 • 이를 통해 고부가가치 시장에서의 입지를 다짐
<p>성장하는 eSSD 시장</p>	<ul style="list-style-type: none"> • eSSD 시장은 2021년부터 2026년까지 연평균 15% 성장이 전망됨 • 이는 관련 플라스틱 사출품 수요 증가로 이어질 것으로 예상됨
<p>시장 변화 대응 능력</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 시장은 코로나 이후 공급망 리드타임 증가 문제로 인해 제조 유연성의 요구가 높아짐 • 동사는 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 보유함

8) 턴키 박스(Turnkey Box): SSD의 완제품 패키징을 위한 종합 솔루션

I. 기업 현황

반도체 운반용 트레이와 SSD 관련제품을 제조하는 전문기업

동사는 반도체 공정소재와 SSD 관련제품을 개발 및 제조하는 업체로, 주력 제품을 바탕으로 적극적인 영업과 해외 현지법인 활성화를 통해 매출 확대를 추진 중이다. 또한 원재료 개선과 신기술 개발을 통해 수익성 경쟁력을 강화하고 있다.

■ 회사의 개요

동사는 1997년 3월 범일엔지니어링(주)로 설립되어 반도체 공정소재를 제작 및 판매하기 시작했으며, 2000년 1월에는 비아이이엠티(주)로 상호를 변경했다. 2003년 6월 모듈 트레이(Module Tray) 사업을 시작으로, IC 트레이(IC Tray)로 품목을 확대하여 반도체 공정소재 부문에서 성장 기반을 마련했고, 이어 반도체 소모품인 캐필러리(Capillary) 제품을 추가하며 시장에서의 입지를 다져왔다. 이러한 성장을 바탕으로 2005년 1월 코스닥 시장에 상장하였다. 한편, 동사의 본사는 충청남도 아산시에 위치하고 있으며, 글로벌 생산 인프라 확보를 위해 중국, 필리핀, 베트남에 현지법인을 설립한 것으로 파악된다.

표 1. 동사 주요 연혁

일자	연혁 내용
1997.03	범일엔지니어링(주) 설립
1997.09	Ceramic Capillary(Bonding Tool) 사업개시(삼성전자(주) 중소기업 기술 이관업체 지정)
1998.04	기업부설 기술연구소 인가(한국산업기술진흥협회)
2000.01	비아이이엠티(주) 상호변경
2000.03	벤처기업 등록 (중소기업청) - 연구개발투자기업
2000.04	Capillary 소재 국산화 완료 및 특허 출원
2003.06	진공성형(Module Tray) 사업 개시
2003.12	중국현지법인(소주케이엑스반도체재료유한공사) 설립
2004.05	Carrier Tape 사업 개시
2005.01	코스닥시장 상장
2009.09	LED원재료인 사파이어 잉곳 사업 개시
2010.10	필리핀 현지법인(KX HITECH PHILS) 설립
2010.02	미국 Entegris 社 FOSB 기술협약 체결
2012.07	LED원재료인 사파이어 잉곳 사업 분할로 비아이신소재(주) 설립
2014.03	비아이신소재(주) 흡수합병
2015.05	중국현지법인(시안케이엑스반도체재료유한공사) 설립
2016.02	(주)케이엠에이치로 최대주주 변경
2016.03	(주)케이엠에이치하이텍 상호변경
2020.01	베트남현지법인(BN KX HITECH) 설립
2021.00	(주)하이텍신소재 지분 취득
2021.08	(주)케이엑스인텍 지분 취득
2022.06	(주)케이엑스하이텍 상호변경

자료: 동사 반기보고서(2024.06.) 및 홈페이지, 한국기술신용평가(주) 재구성

2024년 6월 말 기준, 당사는 SSD 관련제품 사업의 수익성 강화를 목적으로 중국, 필리핀, 베트남에 현지법인을 설립하여 종속회사로 보유하고 있다. 또한 2021년 8월 디지털 위성방송 수신기(셋톱박스)를 제조 및 판매하는 (주)케이엑스인텍의 지분을 취득하며 종속회사로 편입시켰다. (주)케이엑스인텍은 OTT 셋톱박스 수요 증가에 따른 매출 성장세를 지속하며 2023년 매출액은 783억 원으로 역대 최대 실적을 달성하였다.

표 2. 종속회사 현황

(단위: 백만 원, 별도 기준)

상호	설립일	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부
소주케이엑스 반도체재료유한공사	2004.01	반도체 재료 제조 및 판매	3,056	의결권 과반수 소유	미해당
시안케이엑스 반도체재료유한공사	2015.05	반도체 재료 제조 및 판매	2,060	의결권 과반수 소유	미해당
KX HITECH PHILS CORP	2010.03	반도체 재료 제조 및 판매	6,507	의결권 과반수 소유	미해당
BN KX HITECH COMPANY LIMITED	2020.01	반도체 재료 제조 및 판매	25,442	의결권 과반수 소유	해당 ⁹⁾
(주)케이엑스인텍	2005.01	방송수신기 제조 및 판매	36,848	의결권 과반수 소유	해당 ¹⁾

자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

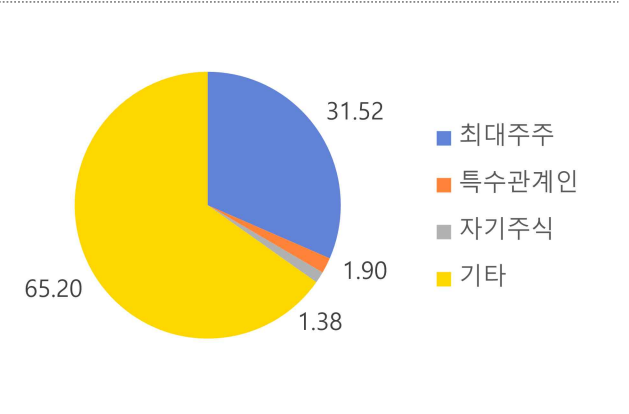
당사의 최대주주는 (주)케이엑스이노베이션으로 31.52%의 지분을 보유하고 있으며, (주)케이엑스이노베이션의 최대주주인 최상주가 1.77%의 지분을 보유하고 있다.

표 3. 동사 지분구조 현황

그림 1. 동사 지분구조 현황

(단위: %)

주주명	관계	주식수(주)	지분율(%)
(주)케이엑스이노베이션	최대주주	17,369,325	31.52
최상주	특수관계인	973,415	1.77
케이엑스하이텍(주)	자기주식	762,797	1.38
이상국	특수관계인	60,000	0.11
강승원	특수관계인	10,000	0.02
우리사주조합	-	1,500	0.00
기타	-	35,930,480	65.20
합계		55,107,517	100.00



자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

■ 대표이사

강천석 대표이사는 성균관대학교 경영학 석사학위를 취득했다. 또한 1989년에 삼성전기(주)에 입사하여 25여년간 근무하였으며, 경영혁신 그룹장을 역임하였다. 이후 2015년 1월 (주)우주일렉트로닉스로 이직하여 IT사업 총괄 부사장으로 역임하다가, 2024년 3월 동사 대표이사로 선임되어 경영을 총괄하고 있다.

9) 직전년도 자산총액 10%이상

■ 주요 사업 분야

동사의 주요 사업 분야는 반도체 공정소재와 SSD 관련제품으로 구분된다. 반도체 공정소재는 플라스틱 사출을 통해 생산되며, 주요 제품으로는 반도체 소자를 외부 충격이나 정전기 등으로 부터 보호하는 IC 트레이(IC Tray)와 정밀전자 부품(LCD Module)을 외부 충격이나 전자파로부터 보호하는 고기능 모듈 트레이(Module-Tray) 등이 있다. 한편 SSD의 주요 제품으로 SSD를 보호하는 SSD 인클로저(SSD Enclosure)가 있으며, 사용 설명서와 제품 라벨 등을 포함하는 턴키 박스(Turnkey Box)가 있다.

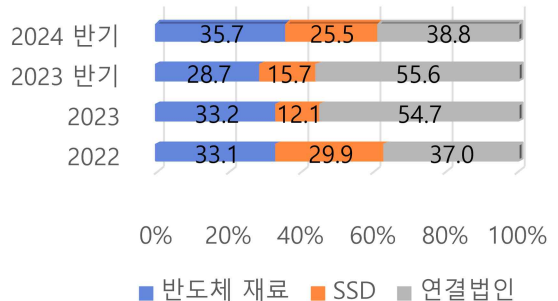
■ 주요 사업부문별 매출실적

동사의 반도체 공정소재의 수요는 메모리 생산량과 연동된다. 2023년 메모리 업계의 감산으로 동사의 플라스틱 부품 수요가 다소 부진했다. 또한 글로벌 반도체 공급망 차질로 인해, 2023년 SSD 관련제품의 매출액은 187억 원으로 전년대비 60.1% 감소했다. 그러나 연결법인인 (주)케이엑스인텍의 OTT셋톱박스 실적 호조로 846억 원을 기록하며 전년대비 46.4% 증가해 매출 감소를 상쇄했다. 또한 2024년에는 반도체 업황 개선으로 인해 매출이 개선될 것으로 기대되고 있다. 한편, 2024년 연결기준 반기 매출액은 644억원을 기록, 전년 동기대비 10.7% 감소하였으나, 이는 연결법인의 영향으로 원사업인 반도체 및 SSD 사업은 매출호조로 전년동기 대비 실적이 23.1% 개선되었다.

표 4. 사업부문별 매출실적 (단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

그림 2. 사업부문별 매출비중 (단위: %)

사업부문	2022	2023	2023 반기	2024 반기
반도체 공정소재	518	514	207	230
SSD 관련제품	468	187	113	164
연결법인	578	846	401	250
합계	1,564	1,547	721	644



자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

E	<p>환경경영</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 환경보호: 유해화학물질 및 폐기물 관리, 작업 환경 측정 ◎ 안전보건 관리: 무재해 사업장 유지, 위험성 평가 및 안전한 사업장 구축, 비상사태 대응체계 환경 구축 ◎ 탄소중립 생활 실천: 일회용품 사용 최소화, 생활 속 온실가스 줄이기 실천
S	<p>사회책임경영</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 사회공헌: 지역사회 문제 발굴 및 개선, 취약계층 후원 ◎ 동반성장: 공정거래 및 파트너십 강화, 공정거래협약 체결, 협력업체 지원 활동, 하도급법 준수, 상생경영 ◎ 인권경영: 국내 근로기준법 및 국제노동기구(ILO) 규정 준수, 인권 존중 및 차별금지 등
G	<p>기업지배구조</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 준법경영: 준법경영 준수, 윤리문화 구축, 고용평등, 반부패 및 공정성 강화 ◎ 정도경영: 정도경영 실천, 투명한 기업운영, 사내·외 이사회 운영 ◎ 책임경영: 지배구조 부분 책임경영 강화, 이해관계자와 적극적 소통, 주주가치 제고

II. 시장 동향

플라스틱 사출시장의 새로운 기회와 과제: eSSD 시장 성장과 제조 유연성 요구

플라스틱 사출시장은 전반적으로 성숙기에 진입했지만, 정밀산업 분야에서 새로운 성장 기회가 존재한다. 특히 eSSD 시장은 2021년부터 2026년까지 연평균 15% 성장이 전망되며, 이는 관련 플라스틱 사출품 수요 증가로 이어질 것으로 예상된다. 다만, 코로나 이후, 정밀산업은 공급망 리드타임이 증가하는 문제를 겪고 있어, IDM 및 파운드리 업체들은 부품 제조업체에 제조 유연성을 요구하고 있다. 이에 대응하기 위해서는 생산 프로세스 유연성 향상, 재고 관리 최적화 등의 전략이 필요하다.

■ 성숙기 시장 속에 존재하는 새로운 기회

동사의 주요 사업 영역은 반도체 공정소재와 SSD 관련제품으로 나뉜다. 또한 기술 개발 실적을 확인한 결과, 주로 플라스틱 소재 및 가공 기술에 집중하여 개발을 진행한 것으로 확인된다. 이는 동사가 정밀소재 기술과 정밀 사출 기술을 핵심 경쟁력으로 삼고 있음을 시사한다. 이를 고려할 때, 동사의 목표시장은 반도체용 플라스틱 제품 시장으로 정의하는 것이 적절할 것으로 판단되며, 그 중에서도 특히 반도체용 플라스틱 사출시장이 동사의 핵심 목표시장으로 적합할 것으로 사료된다.

표 5. 동사의 주요 제품 및 매출액

주요 제품	매출액(2024.반기)	설명
반도체 공정소재	230억 원	<ul style="list-style-type: none"> 플라스틱 사출 기반의 반도체 공정소재를 생산 IC 트레이(IC Tray), 모듈 트레이(Module Tray), 캐리어 테이프(Carrier Tape), 웨이퍼 링 캐리어(Wafer Ring Carrier) 등
SSD 소재	164억 원	<ul style="list-style-type: none"> SSD Enclosure(SSD 금속 케이스)와 Turnkey Box 제작. 제품라벨 등 일괄 포장된 제품을 주요 고객사에 공급

자료: 동사 반기보고서(2024.06.)

한편, 시장 조사기관인 Grand view research에 따르면, 플라스틱 사출시장은 현재 성숙기에 진입한 것으로 파악된다. 일반적으로 시장이 성숙기에 접어들면 기술 발전의 속도가 둔화되고, 기존 기술이 표준화되며, 혁신의 가능성이 줄어든다. 이에 해당 시장의 기술 또한 대부분 성숙 단계에 도달했을 가능성이 높아진다. 따라서 성숙기 시장에서는 기술 혁신보다 『원가 절감』과 『생산 유연성』 같은 운영 효율을 높이는 것이 중요하다. 그러나 플라스틱 사출시장 내에서도 새로운 성장 기회가 확인된다. 반도체 산업의 eSSD와 이차전지의 NCM(니켈, 코발트, 망간 복합 양극재) 등의 고성능 부품은 민감도와 안정성이 더욱 중요해지면서, 이를 보호하기 위한 고품질 플라스틱 제품의 수요가 증가하고 있다. 특히 부품 보호용 포장재, 트레이, 운반 케이스 등의 수요가 늘어나고 있어, 플라스틱 사출 산업에 새로운 기회를 제공하고 있다.

이러한 정밀산업의 요구에 부응하기 위해, 플라스틱 사출품 제조업체들은 기술 혁신과 품질 향상에 주력해야 할 것이다. 또한 고객사에서 요구하는 내열성, ESD(정전기 방지) 등의 품질기준을 충족할 수 있는 기업들은 시장점유율을 확대할 수 있을 것이다. 따라서 플라스틱 사출시장이 전반적으로 성숙기에 접어들었다고 하더라도, 여전히 성장의 기회가 존재한다고 볼 수 있다.

■ eSSD 시장의 성장에 따른 기회

정밀산업 중에서도 eSSD 시장은 빠르게 성장하고 있다. 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, AI, 빅데이터 분야에서 고성능 메모리 반도체 수요가 증가하고 있기 때문이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 2023년 4분기 글로벌 eSSD 시장은 매출액 기준 전분기 대비 47.6% 증가한 23억 1,000만 달러(약 3조 758억 원)를 기록했다. 또한, 2024년 3분기 eSSD 계약 가격은 2023년 4분기 대비 80% 이상 상승했으며, 올해 하반기 eSSD 수요 확대에 의해, 계약가격이 최대 20% 추가 상승할 것으로 예상된다.

이는 플라스틱 사출업체에게 새로운 기회가 될 것으로 기대된다. eSSD 생산량 증가에 따라, 인클로저 등 플라스틱 사출품 수요도 함께 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 따라서 플라스틱 사출업체는 eSSD에 요구되는 고성능, 내구성, 열 관리 등의 기술력을 확보한다면 사업 확대를 기대할 수 있을 것이다.

■ 정밀산업의 이슈: 공급망 리드타임 증가

eSSD를 포함하는 정밀산업은 COVID-19 팬데믹 이후 『공급망 문제』를 직면하고 있다. 딜로이트(Deloitte)에 따르면, 최근 정밀산업의 공급망은 리드타임(Lead Time)이 회복되는 추세를 보이나, 여전히 팬데믹 이전 수준을 회복하지 못하고 있다.

리드타임이란 제품이나 부품을 주문하고 그것이 생산되어 준비가 완료되기까지 걸리는 시간을 의미한다. 다음 그림을 볼 때, 팬데믹 이전인 2020년 초에 정밀산업의 리드타임은 약 63일이었으나, 2021년 중반부터 급격히 증가하기 시작했다. 이후 2022년 초에는 사상 최고치인 약 100일까지 치솟다가, 다소 개선되어 2023년 현재 약 87일로 감소했지만, 이는 여전히 팬데믹 이전 대비 37% 증가한 수준이다.

그림 3. 정밀산업의 연도별 리드타임



자료: Deloitte Global, '2024 manufacturing industry outlook' (2024.03), 한국기술신용평가(주) 재가공

이러한 상황에서 IDM(Integrated Device Manufacturer) 및 파운드리 업체는 납품업체에게 제조 유연성을 요구하고 있다. 급변하는 시장 수요와 공급망 불안정성에 신속하게 대응할 수 있어야 하기 때문이다. 따라서, 부품 제조업체는 생산 프로세스의 유연성 향상, 재고 관리 최적화, 다양한 공급원 확보 등의 전략을 갖출 필요성이 있다. 즉, 플라스틱 사출업체를 포함한 부품 제조업체는 유연한 생산 체계 구축을 확보한다면, 시장 변화에 적절히 대응하고, 장기적으로 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 보인다.

III. 기술분석

동사가 수행하는 사출기술: 원가절감 기술과 제조 유연성

동사는 플라스틱 사출 산업에서 요구되는 다양한 기술력을 확보한 것으로 파악된다. 원가절감에 사용되는 자동 원자재 관리, 정밀 사출 공정 자동화, 자동화된 품질 관리 시스템 기술을 보유하고 있으며, 제조 유연성 측면에서는 폭넓은 제품군 생산 능력 등을 보유하고 있다. 이러한 기술력을 바탕으로 주요 고객사의 맞춤형 요구에 대응할 수 있는 역량을 갖춘 것으로 파악된다.

하버드대학교 경영대학원 석좌교수인 Michael Porter가 제시한 경쟁 전략 이론에 따르면, 성숙기에 접어든 산업에서는 『원가절감』과 『제조 유연성』이 중요해진다. 또한 시장조사기관 Grandview Research에 따르면, 플라스틱 사출시장은 기술적으로 대부분 성숙 단계에 진입한 상태로 파악된다. 이러한 배경에서 동사는 『원가절감 기술』과 『제조 유연성』을 확보한 것으로 확인된다.

■ 원가절감 기술

원가절감 기술은 크게 다섯 가지로 구성되며, 동사는 이 중 자동화 기술, 공정 최적화, 오프쇼어링 세 가지 전략 위주로 취하는 것으로 확인된다.

표 6. 주요 원가절감 기술

분류	설명
린 제조기술 (Lean Manufacturing)	<ul style="list-style-type: none"> 불필요한 과정과 자원 낭비를 줄이고, 생산 과정을 간소화하고 효율적으로 만드는 기술 결과적으로 생산효율성과 품질을 높이고, 생산비용을 낮춤
자동화 기술 (Automation Technology)	<ul style="list-style-type: none"> 기계, 로봇, 컴퓨터 시스템을 생산 과정에 도입하는 기술 반복적이거나 위험한 작업을 기계가 대신 수행하여, 생산 속도를 높이고 오류를 줄임
공정 최적화 (Process Optimization)	<ul style="list-style-type: none"> 생산 과정의 모든 단계를 세밀히 분석하여 효율적인 개선 방법을 찾아 적용하는 기술 시간과 자원을 최대한 효과적으로 사용
규모의 경제 (Economies of Scale)	<ul style="list-style-type: none"> 생산량을 늘려 단위당 생산 비용을 낮추는 전략. 공급망 구축 등의 기술노하우가 필요 대량 구매로 원자재 비용 절감하고, 더 많은 제품을 더 저렴하게 생산 가능
오프쇼어링 (offshoring)	<ul style="list-style-type: none"> 생산시설을 비용이 적게 드는 해외로 이전하고, 현지에 맞는 생산 시스템을 구축하는 전략 이를 통해 인건비와 운영비를 줄여 가격 경쟁력을 확보

자료: Journal of Manufacturing Technology Management, "Impact of Lean Manufacturing and Industry 4.0 on Operational Performance: A Study in the Manufacturing Sector." (2021.05), 한국기술신용평가(주) 재가공

구체적으로, 동사는 한 공정 안에 ① 자동 원자재 관리 및 분배 시스템 → ② 정밀 사출 공정 자동화 → ③ 자동화된 품질 관리 시스템 등을 구축하여 원가절감을 이룬 것으로 파악된다. 또한 이를 통해 생산 효율성 극대화, 품질 일관성 확보, 자원 최적화 등 다양한 효과를 얻는 것으로 사료된다.

그림 4. 동사의 자동화 기술 및 공정순서

① 자동 원자재 관리 및 분배 시스템	② 정밀 사출 공정 자동화	③ 자동화된 품질 관리 시스템
<ul style="list-style-type: none"> • 특수 설계된 파이프로 원자재를 자동으로 사출 기계에 공급함 • 센서로 원자재를 감지하고 정확한 양을 공급하여 낭비 최소화함 	<ul style="list-style-type: none"> • 사출 공정에 가장 알맞은 온도와 압력을 자동으로 조절함 • 빠르고 정확한 생산으로 전체적인 생산성을 향상함 	<ul style="list-style-type: none"> • 열변형 방지 목적의 어닐링 설비를 활용하여 제품을 검사 및 품질 유지 • 미리 정해진 품질기준에 따라 불량품을 자동으로 선별함

자료: 현장 실사(2024.08)

또한 동사는 SSD 제조 공정을 베트남으로 이전하는 오프쇼어링을 통해, 원가절감을 이룬 것으로 확인된다. SSD 제조는 주조, 프레스, 연마, 아노다이징, CNC 가공, 도장, 세척 등 여러 단계를 거치는 노동집약적 공정이다. 이러한 특성 때문에 인건비 비중이 높다는 단점이 있으나, 동사는 베트남으로 생산기지를 이전하여 인건비를 70% 이상 절감한 것으로 제시하고 있으며, 추가적인 경제이익까지 얻을 것으로 기대하고 있다.

표 7. 베트남 생산기지 이전 시, 예상되는 추가적인 경제이익

장점	세부 내용
무역 협정 혜택	EU-Vietnam FTA 및 CPTPP 등의 자유무역협정을 통해 유럽 및 미국 수출 시 관세 혜택
산업 인프라 확충	산업단지외 물류 인프라 확충 중, 베트남 물류 성능지수 국제 39위
공급망 다변화	베트남은 중국과 가까워 원자재 조달에 유리, 미국의 무역 제재에 해당되지 않음

자료: Vietnam Briefing, 'Why Manufacturing is Driving Vietnam's Growth', (2022.01), 한국기술신용평가(주) 재가공

■ 제조 유연성

제조 유연성은 불필요한 낭비 요소를 제거하고 효율성을 극대화하는 제조 역량을 의미한다. 또한 제조 유연성의 핵심 요소는 ① 유연 생산 시스템의 구축 여부, ② 다양한 품목의 생산 경험과 포트폴리오 보유 여부, ③ 모듈식 설계 기술로 확인된다.

표 8. 제조 유연성의 핵심 요소

구분	설명
① 유연 생산 시스템 (Flexible Manufacturing Systems)	다양한 제품을 효율적으로 생산할 수 있는 자동화된 시스템을 구축하여, 빠른 제품 전환과 생산량 조절이 가능함
② 다양한 생산 경험과 포트폴리오 (Diversified Production Experience and Portfolio)	여러 종류의 제품 생산 능력을 보유하여 다양한 산업 분야와 고객 요구에 대응할 수 있음
③ 모듈식 설계 (Modular Design)	제품을 독립적인 모듈 단위로 설계하여 다양한 제품 구성이 가능하고 생산 효율성과 유연성을 향상시킴

자료: Boston Consulting Group, 'Lean Manufacturing Demands Agile Production and Support' (2020.04)

동사는 다양한 생산 경험과 풍부한 포트폴리오를 보유한 것으로 파악된다. 이는 플라스틱 용기 제조부터 반도체 운반용 플라스틱 제조에 이르는 폭넓은 제품군 생산 실적에서 확인할 수 있다. 구체적으로, 반도체 공정 소재 생산에서는 웨이퍼 링 캐리어(Wafer Ring Carrier), IC 트레이(IC Tray), 모듈 트레이(Module Tray), 캐리어 테이프(Carrier Tape) 등 전후공정에 필수적인 부품을 제공하고 있으며, SSD 관련 기술에서는 정밀 가공 및 표면 처리 기술을 적용한 SSD 인클로저(SSD Enclosure) 제조와 턴키 박스(Turnkey Box) 솔루션을 생산하고 있다.

이러한 다양한 기술력을 바탕으로, 동사는 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), Micron, 하나마이크론(주) 등 주요 고객사의 다양한 요구에 대응하며, 각 고객사의 제품 스펙과 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품 설계 및 생산을 수행하고 있다.

표 9. 동사의 사업 분야별, 보유 기술

대분류	중분류	보유 기술
사업 분야	반도체 공정소재	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 제조 공법: 다이캐스팅(Die-casting), 스탬핑(Stamping), 사출 성형(Injection Molding) 후공정 기술: 샌딩(Sanding), 헤어라인(Hair Line), 아노다이징(Anodizing), ED 코팅(ED-Coating), CNC 가공(CNC), C-컷(C-Cut), 태핑(Tapping) 등 사용 소재: 금속(Metal) (알루미늄(AL), ALDC 12 등), 플라스틱(Plastic) (폴리카보네이트(PC))
	SSD 관련소재	<ul style="list-style-type: none"> 정밀가공 기술 및 품질관리 시스템: CNC 가공 초정밀 금형 제작, 미세 결함 검사, 치수 측정 및 관리 표면처리 기술 및 조립기술: 아노다이징, 도금, 코팅, 초음파 용접 접착 기술
주요 고객사	삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), Micron, 하나마이크론(주)	

자료: 동사 제공 자료, 한국기술신용평가(주) 재가공

IV. 재무분석

2023년 메모리 업계 감산으로 인해 매출 실적 부진, 수익성 하락

2023년 주요 반도체 고객사의 감산에 따라 반도체 공정소재 및 SSD 관련제품의 공급이 부진하여 매출이 정체되었고 수익성 또한 하락하였다. 2024년 상반기에는 기타 연결법인 실적 감소로 전체 매출액은 감소하였으나, 반도체 업황 개선으로 주요 사업 부문 매출이 회복, 증가하였고 원가 및 판관비 절감 노력으로 수익성이 개선되었다.

■ 2023년 메모리 업계 감산으로 인해 전년도 수준의 매출액 시현, 성장세 부진

최근 3년간 매출액 실적은 2021년 1,049억 원, 2022년 1,564억 원으로 각각 40.4%, 49.1% 성장했다. 2022년은 동사 사상 최대 실적을 기록했다. 4분기 반도체 감산에도 불구하고 연중 견조한 반도체 수요로 반도체 재료와 SSD 사업부가 성장했으며, 특히 SSD 케이스 매출이 증가했다. 2023년에는 1,547억 원으로 전년 대비 1.1% 감소했다. 종속기업의 위성방송 수신기 수주 호조에도 주요 반도체 고객사의 감산으로 반도체 공정소재 및 SSD 관련제품 공급이 부진했다.

한편, 2024년 상반기 매출액은 644억 원으로 전년동기대비 10.7% 감소했다. 반도체 업황 개선으로 반도체 재료부문과 SSD 부문 매출이 각각 11.1%, 45.1% 증가했으나, 기타 연결법인 매출이 37.7% 감소했다.

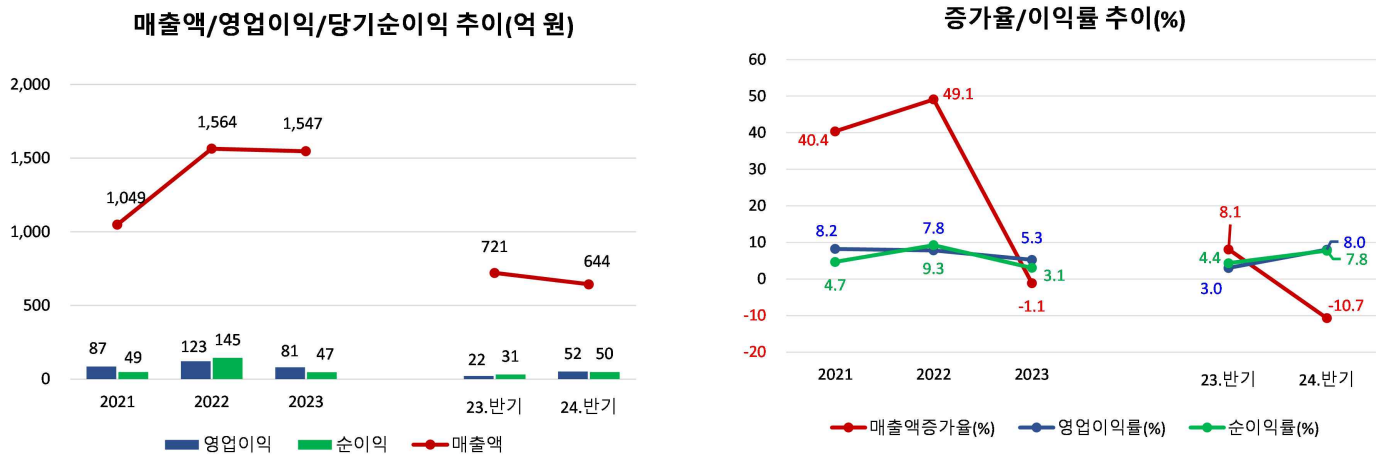
■ 2023년 매출액 부진과 더불어 수익성 하락, 2024년 원가 및 비용 절감에 따라 수익성 개선

2021년과 2022년 매출액 고성장에 힘입어 영업이익 또한 2021년 87억 원으로 8.2%의 영업이익률을 기록하였고 2022년에는 123억 원의 영업이익을 시현하며 7.8%의 영업이익률을 기록하였다. 2023년에는 매출실적이 전년도 수준에 그치는 등 실적이 부진하였고 원가율이 상승한 가운데 지급수수료 증가 등 판관비 부담도 가중되며 영업이익률은 전년대비 2.5%p하락, 영업이익 81억 원, 영업이익률 5.3%를 기록하였다. 영업외수지 저하의 영향으로 순이익률도 전년대비 6.2%p하락하면서 순이익 47억 원, 순이익률 3.1%를 기록, 매출액 부진과 함께 수익률 또한 하락하는 모습을 보였다.

한편, 2024년 상반기 매출액은 10.7% 감소하였으나 베트남 박닌 현지법인으로 국내 SSD 생산라인을 이전하는 등 효율적인 자원관리와 생산 공정의 최적화를 통해 제조원가를 전년대비 12.6% 절감함에 따라 영업이익 52억 원으로 영업이익률 8.0%를 기록하였다. 또 전사적 인적·비용관리 등 운영 최적화를 통해 판매관리비를 전년동기대비 27.0% 줄이면서 순이익 50억 원, 순이익률 7.8%를 시현하는 등 수익성이 개선되었다.

그림 5. 동사 손익계산서 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)



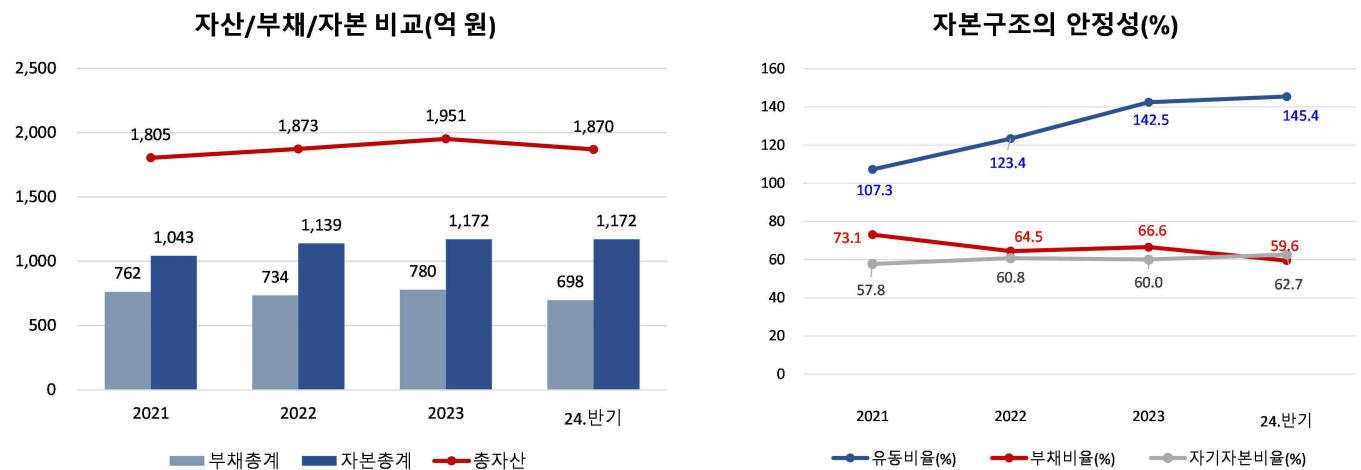
자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

■ 주요 재무안정성 지표 양호한 수준을 보이고 있는 가운데 소폭 개선 추세

동사의 부채비율은 지속적인 순이익 실현에 따른 자본 확충으로 2021년 73.1%, 2022년 64.5%, 2023년 66.6%를 기록하며 최근 3개년간 개선되는 추세를 보였다. 2024년 상반기 말에는 59.6%로 더욱 개선되었다. 유동비율도 2021년 107.3%, 2022년 123.4%, 2023년 142.5%, 2024년 상반기 말 145.4%로 개선세를 유지했다. 2024년 상반기 말 현재 차입금의존도는 17.9%로 외부자금 의존도가 낮으며, 영업활동을 통한 자금 창출력은 소요자금 충당에 충분한 수준이다. 자기자본비율은 2021년 57.8%, 2022년 60.8%, 2023년 60.0%, 2024년 상반기 말 62.7%로 재무안정성이 개선되는 추세를 보였다.

그림 6. 동사 재무상태표 분석

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

표 10. 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2023.06	2024.06
매출액	1,049	1,564	1,547	721	644
매출액증가율(%)	40.4	49.1	-1.1	8.1	-10.7
영업이익	87	123	81	22	52
영업이익률(%)	8.2	7.8	5.3	3.0	8.0
순이익	49	145	47	31	50
순이익률(%)	4.7	9.3	3.1	4.4	7.8
부채총계	762	734	780	823	698
자본총계	1,043	1,139	1,171	1,136	1,172
총자산	1,805	1,873	1,951	1,959	1,870
유동비율(%)	107.3	123.4	142.5	144.2	145.4
부채비율(%)	73.1	64.5	66.6	72.5	59.6
자기자본비율(%)	57.8	60.8	60.0	58.0	62.7
영업활동현금흐름	109	138	147	44	40
투자활동현금흐름	-337	-223	-104	-71	30
재무활동현금흐름	336	53	45	89	-15
기말의현금	141	109	197	171	252

자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

동사는 2024년 상반기 실적을 기반으로 하반기에도 원가 관리와 효율성 향상을 통해 경쟁력을 유지할 것으로 예상된다. 또한 2024년 DDR5 중심의 반도체 업황 개선, AI 관련 SSD 출하량 증가, 중속기업의 성장으로 매출액 증가가 예상된다. 수익성 측면에서는 국내 SSD 사업 설비의 베트남 이전으로 원가 개선이 기대된다.

그림 7. 동사 실적 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

매출액 실적 전망(억 원)

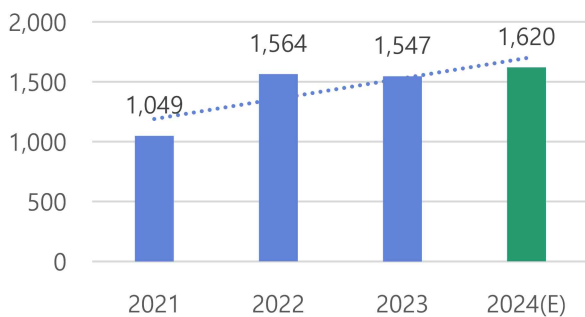


표 11. 사업부문별 실적 전망

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2024(E)
매출액	1,049	1,564	1,547	1,620
반도체 공정재료	413	518	514	520
SSD 관련소재	329	468	187	400
연결법인	307	578	846	700

자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

자료: 동사 반기보고서(2024.06.), 한국기술신용평가(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

AI 산업 성장에 따른 동사의 eSSD 인클로저 기술력과 향후 전망

동사는 eSSD 인클로저(eSSD Enclosure) 제조에 필요한 전 과정의 기술력 다이캐스팅(Die-casting), 스탬핑(Stamping), 사출 성형(Injection Molding), ED 코팅(ED Coating) 등을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 현재 eSSD 시장에서 경쟁력을 확보했으며, AI 수요 증가에 따라 시장 점유율 상승이 기대된다.

■ AI 수요 증가에 따른 동반 성장 기대

AI 기술의 급속한 발전으로 기업용 SSD(eSSD) 시장이 빠르게 성장하고 있다. eSSD는 일반 SSD와 달리 24시간 가동되며 방대한 데이터를 처리하기 때문에, 소비자용 SSD보다 높은 성능과 내구성이 요구된다. 이러한 시장 변화에 따라 SSD 인클로저 제조업체들은 더욱 특화된 제조 기술과 품질 관리 능력을 갖추어야 하는 상황에 직면해 있다.

표 12. eSSD 핵심 기능 및 SSD 인클로저 제조업체 요구 기술 역량

SSD 대비 eSSD에 요구되는 핵심 기능	SSD 인클로저 제조업체에 요구되는 핵심기술 역량
정밀성: 정확한 치수가 필요함	정밀 제조역량: 정확한 치수관리로 성능 유지
내구성 강화 기술: 지속적인 사용과 높은 작업량에 대비한 장기적 신뢰성 확보가 필요함	내구성 및 진동 저항성 강화: 견고한 설계로 장기간 사용 보장 고품질 소재 사용: 내구성이 뛰어난 소재 선택
열 관리: 24시간 고성능 작동 시 발생하는 열을 효과적으로 제어하여 성능 저하 기능이 필요함	열 관리 및 방열 성능 강화: 효율적인 냉각 기술 필요 후공정 기술 적용: 방열효과를 높이는 표면처리
EMI/RFI 차폐 기술: 데이터 센터 환경에서 전자파 간섭을 최소화하여 데이터 무결성 유지할 수 있어야함	EMI/RFI 차폐 기능 강화: 전자파 간섭 최소화 설계 고품질 소재 사용: 전도성 소재를 사용하여 차폐성능 향상

자료: 동사 제공 자료, 한국기술신용평가(주) 재가공

이러한 배경에서, 동사는 eSSD 인클로저 제조업체에게 요구되는 핵심기술 역량을 갖춘 것으로 파악된다. 동사가 보유한 대표적인 기술은 다음과 같다.

표 13. 동사가 보유한 eSSD 관련 핵심기술

구분	내용	구분	내용
다이캐스팅 (Die Casting)	알루미늄 합금, 고압 주입, 대량 생산	샌딩 (Sanding)	표면 연마, 질감 개선
스탬핑 (Stamping)	금속 판재 성형, 대량 생산 최적	헤어라인 처리 (Hair Line)	금속 표면 선형 패턴, 고급 외관
사출 성형 (Injection Molding)	플라스틱 용융, 복잡한 부품 제작 특히 진공을 활용한 기술을 보유함	아노다이징 (Anodizing)	산화 피막, 내식성 및 내구성 강화
ED 코팅 (ED-Coating)	균일 코팅, 내후성 및 내구성 향상	CNC 가공 (CNC)	정밀 가공, 복잡 부품 제작

자료: 동사 제공 자료, 한국기술신용평가(주) 재가공

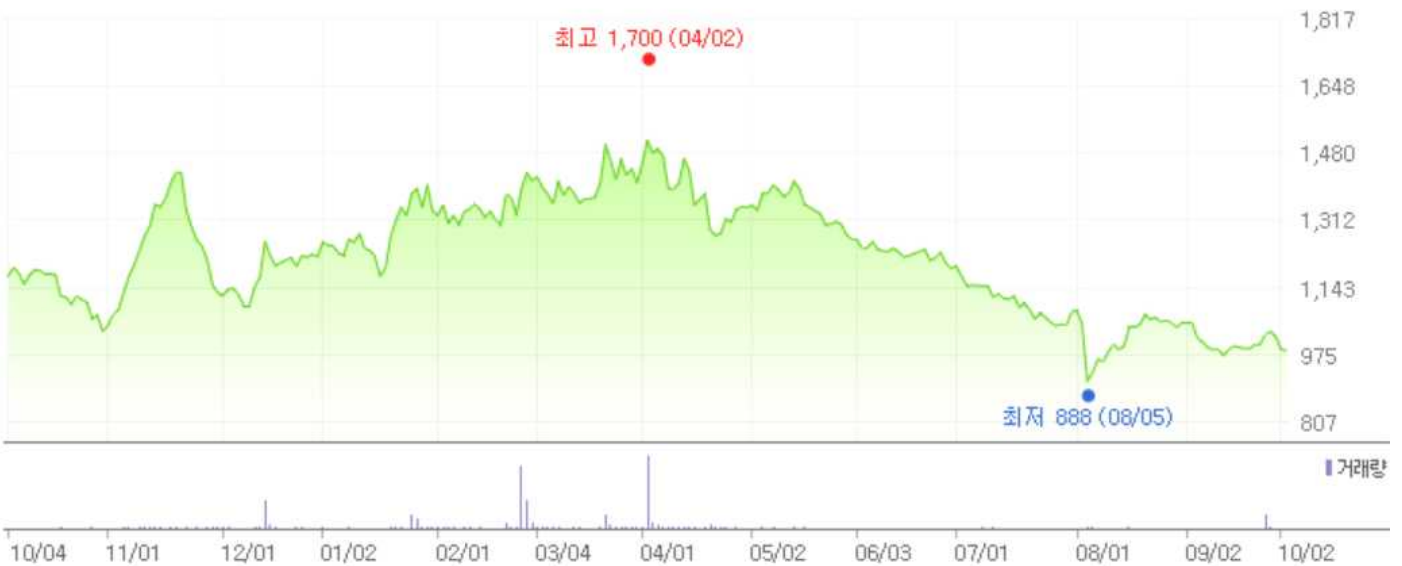
이처럼 동사는 현재 eSSD 시장에서 경쟁력을 확보한 것으로 판단되며, 이에 향후 eSSD 수요 증가와 기술 고도화에 따라, 시장 점유율을 높일 것으로 기대된다.

증권사 투자 의견

작성기관	투자 의견	목표주가	작성일
-	-	-	-

투자 의견 없음.

시장 정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2024.10.02.)

최근 6개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자 주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
KX하이텍	X	X	X